

新型特种印制电路板产业化（一期）建设配套项目设计要求

一、建筑规模：规划建设一栋研发厂房，钢筋混凝土框架结构，负一层地下室面积约 2500 平方米，地面以上计容建筑面积约 11,700 平方米，总建筑面积约 14200 平方米。建安工程费约 6000 万元。

二、建筑设计参数：

- 1、层数：6 层
- 2、建筑总高度：23.8 米
- 3、层高：负一层地下室净高 5 米，1 层 4.5 米，2 层 4 米，3-6 层 3.6 米
- 4、厂房设置货梯和客梯

三、建筑主要功能布局：

- 1、负一层：地下双层机械停车库
- 2、一层：材料准备间
- 3、二层：设备维修及机加工间
- 4、三至六层：研发办公区
- 5、新厂区在东南面兴安路设置大门
- 6、本项目给水、动力电源、空调冷水等从毗邻动力站驳接。

四、主要配套设施：

- 1、西南角规划蓄冷节能项目（设置 2 个直径 10 米、高 20 米的水罐）
- 2、屋面预留约 1,700 平方米太阳能板安装位置
- 3、本项目给水、动力电源、空调冷水等从毗邻动力站驳接

四、设计工作内容：

- 1、初步设计（含效果图）及概算；
- 2、施工图设计（包括但不限于以下专业）：
建筑、结构（包含基坑支护设计）、一般给排水、消防、电气、暖通、通信信息、室外工程、海绵城市、节能设计等。
- 3、二次深化设计方案审核等。
- 4、图纸变更；
- 5、全过程的施工配合服务工作。